

## 存储遇见AI 江波龙在COMPUTEX 2025发布多款重磅新品

深圳 2025年5月21日 /美通社/ -- 5月20日至23日，COMPUTEX 2025在台北南港展览馆1、2馆隆重举行。江波龙以“综合创新，存储遇见AI”为主题，携旗下行业类存储及全球领先的消费类品牌Lexar雷克沙亮相展会，展示在AI时代的创新成果。



### 存储综合创新 AI应用多维突破

围绕AI PC、AI服务器等应用场景，公司推出了多款重磅新品，为AI领域打造更全面且高效的存储解决方案。

#### 8TB XP2350 QLC NAND PCIe SSD

#### AI PC的存储利器

QLC SSD因其高密度和读性能，适合频繁更新但不需高频重写的AI数据集，既能满足数据存储需求，又能降低能耗、减少成本，在读密集场景中具备优势，有望成为AI时代的“存储利器”。

#### 数据保持能力：搭载Floating Gate架构QLC NAND

Flash，具备优异的数据保持能力，支持全生命周期的数据保存标准。相比Charge Trap架构，Floating Gate技术在数据一致性与安全性方面表现更出色，为关键数据保驾护航。

高存储密度：在相同的物理空间内，该产品能够存储更多数据，单盘容量可达8TB，用更少的SSD数量满足AI PC大容量需求，从而优化CPU总线接口，平衡硬件数量，显著降低PC设备AI化的成本。

高性能读写：顺序读写性能高达7200MB/s和5600MB/s，随机读写性能均高达740K IOPS，助力AI模型更快获取训练数据，加速模型训练过程。

**高耐久度：**满足3000 P/E擦写次数，耐久度远超常规QLC SSD产品，可与TLC SSD相媲美，满足AI PC、商用PC整机对寿命和数据安全性的苛刻要求，为用户带来长效、稳定的存储体验。

**自研固件与功能：**在PTM商业模式下，产品标配APST、S.M.A.R.T以及TCG Pyrite 2.0加密等功能。

**软硬件定制：**同时支持更多软硬件定制，以适配具体的AI应用场景。



工规级 BGA SSD

工控系统的小型化存储

产品采用PCIe Gen4 × 4接口，相较于消费类BGA SSD，有着更高标准的可靠性，专为智能汽车、工业电脑、三防加固平板电脑、智能网卡等严苛应用场景设计，适配小型化、高稳定性汽车/工业存储需求。

**高速读写性能：**顺序读写速度高达7000MB/s与6500MB/s，随机读写性能均高达1000K IOPS，能够快速处理大量数据。

**宽温度范围：**工作温度范围在-40 ~85 之间，具备三档选择，适应各种极端环境条件。

**紧凑尺寸设计：**尺寸仅16 × 20mm，1TB容量版本厚度压缩至1.33mm (max)，在实现小尺寸的同时，保证高可靠性与高性能的平衡。

**创新封测工艺：**依托苏州封测制造基地的自有封测工艺，实现高度集成化设计，兼具嵌入式存储的小体积和PCIe Gen4 SSD的高性能。

**高效散热解决方案：**采用自主硬件设计和先进散热材料，结合热仿真计算优化热分布与传导性，确保产品在高负载下稳定运行。

温度系统控制：在自研固件算法中引入温度系统控制（Thermal Throttling）功能，有效管理温度，保障长期高速读写的稳定性。

软硬件定制：同时支持更多软硬件定制，以适配具体的工业应用场景。



江波龙工规级BGA SSD

## 旗舰 PCIe Gen5 SSD

游戏玩家与专业生产力的性能巅峰之作

Lexar雷克沙携一众消费类存储产品亮相展会，其中高性能的旗舰级PCIe Gen5 SSD——NM1090 PRO在现场倍受关注。

Gen5旗舰级读写性能：产品读取速度高达14000MB/s，写入速度高达13000MB/s，是Gen4 SSD的2倍，4K随机读取速度则高达2100K IOPS。

大容量、高效功耗管理：搭载旗舰级PCIe 5.0控制器，容量最高可达4TB，同时实现了更优的功耗管理，确保硬盘在高负荷运行时保持低温，提供流畅的性能体验。

DirectStorage技术支持：产品支持DirectStorage技术，不仅减少了CPU的负载，还提升了小文件的读取速度，为高端游戏玩家和专业视觉工作者提供卓越的游戏性能和工作效率。



COMPUTEX 2025江波龙展台-Lexar产品展示区

## 全栈 AI存储：构建端到端生态

从消费级到企业级，江波龙的全栈AI存储解决方案构建了端到端的完整存储生态。

### 端侧 AI的QLC存储布局

在AI技术深度渗透消费电子领域的变革中，公司前瞻性地布局了QLC存储解决方案。

除QLC SSD外，公司推出的QLC eMMC产品市场表现尤为突出。该产品采用3D堆叠工艺，实现存储密度倍增，并搭载自研主控WM6000，整体性能提升超过30%，待机功耗降低至微瓦（uW）级别。

在此基础上，公司还通过超协议设计，进一步开发了eMMC Ultra产品，成功突破eMMC性能瓶颈，带宽提升50%，理论速度可达600MB/s，为AI手机、XR设备等提供了高效率存储方案。



COMPUTEX 2025江波龙展台

## AI算力集群存储解决方案

针对AI算力集群的内存瓶颈，以及AI服务器对大容量数据盘和高性能启动盘的需求，公司在现场设置专区展示企业级内存与SSD解决方案。

MRDIMM产品采用4R x 4架构与信号完整性增强设计，传输速率8800Mbps，较常规RDIMM提升约37.5%，配合DD R5 RDIMM与CXL 2.0内存拓展模块，打造全面的企业级内存组合，能够为千卡级AI训练集群提供高速内存支持。

企业级SATA eSSD产品支持双盘镜像RAID 1技术，UNCIA 3856/3839系列最高可达7.68TB，无论是作为启动盘还是数据盘，都能轻松满足需求。

基于PCIe Gen4接口的高性能eSSD，顺序读写速度高达6800MB/s / 4600MB/s，7.68TB版本通过动态热数据缓存技术，4K随机读取性能达1000K IOPS，配合增强掉电保护功能、多档功耗调节技术等高阶自研固件，满足AI推理服务器的严苛需求。



今年，江波龙推出了搭载自研主控芯片的UFS，覆盖了从4.1到2.1的协议，为AI手机等应用做好了充分准备。未来，公司还将适时推出QLC UFS和QLC eSSD等创新产品，打造从移动终端到数据中心的全栈AI存储布局。通过存储介质的创新、自研控制器架构的优化以及固件算法的深度融合，为AI产业的落地构建坚实的基础。

### PTM商业模式：全方位存储Foundry服务

PTM（存储产品技术制造）商业模式通过整合芯片设计、固件硬件、封装工艺，再到工业设计、测试制造的全方位存储Foundry服务，为客户提供一站式交付。

### 固件开发与功能定制

以SSD为例，在存储Foundry定制过程中，公司能够为客户提供丰富的功能定制选项。从智能的垃圾回收算法到高效的数据压缩技术，从先进的错误纠正码（ECC）机制到灵活的分区管理策略，每一个功能模块都可以根据客户的特定需求进行深度优化和定制。

此外，通过精准的算法优化，公司还能够对SSD的读写速度、延迟、功耗等关键性能指标进行深度定制。

在高清8K全景录像SSD的定制开发中，公司为客户提供了一套全方位优化的高性能存储解决方案。该方案采用全容量pSLC模式，促使顺序读取速度与顺序写入速度双双突破5000MB/s的卓越性能，同时将TBW（总写入量）提升至42000TB，从而精准契合客户的差异化需求，并在实际应用中显著提升了客户终端设备在8K全景录像场景下的连续录制效率，超越客户期望。

### 测试验证与生产交付

测试验证环节对于SSD至关重要，从模拟各种复杂的工作负载场景，到进行长时间的稳定性测试，公司构建了一套全面且严格的测试验证体系。配合中山存储产业园中的测试制造产线，公司能够根据客户需求提供专品专线服务，实现精准交付。

在教育大屏存储的应用场景中，客户对存储的质量提出了极为严苛的标准，而常规的主流商用PC SSD产品难以满足教育行业的特殊需求。为攻克这一难题，公司采取了一系列创新举措：严格加强颗粒筛选流程，精准量化颗粒失效率，并通过先进的技术手段，将SSD的失效率显著降低了300

DPPM。同时，公司为客户量身定制了专用测试产线，大幅提升了交付效率，并进一步优化了产品质量。

未来，江波龙将持续在存储技术创新、AI存储解决方案、PTM存储Foundry等领域发力，不断提升产品、技术、制造能力，助力AI应用的进一步发展和部署。

原文地址：[http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition\\_news\\_226537.html](http://www.china-nengyuan.com/exhibition/exhibition_news_226537.html)